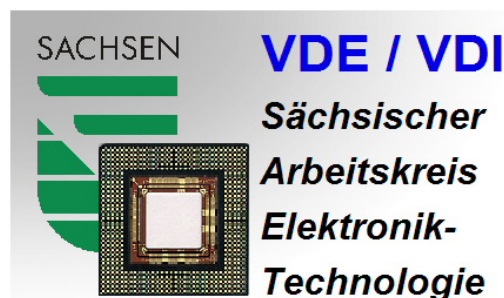


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>



80. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien
und Systeme IKTS

Thema: **Innovative keramische Techniken**

Datum: **Mittwoch, 29. März 2023**

Ort: **Fraunhofer IKTS
Winterbergstraße 28
01277 Dresden**

Programm:

- 10:00 Uhr Begrüßung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und Lars Rebenklau (Fhg IKTS)
- 10:10 Uhr **80. Treffen unseres Arbeitskreises – ein kurzer Rückblick**
Prof. Bauer (Obmann) - HTW Dresden
Dr. Oppermann (Kordinator) – TU Dresden
- 10:30 Uhr **Materialentwicklung für keramische Werkstoffe in der Elektroniktechnologie**
Dr. Uwe Partsch - Fraunhofer IKTS, Dresden
- 10:50 Uhr **Kaffeepause**
- 11:10 Uhr **Inorganische Substrate als Verbindungselement in der Leistungselektronik**
Prof. Hans-Jürgen Albrecht - budatec GmbH, Berlin
- 11:30 Uhr **Funktionalisierte keramische Komponenten – potenzielle Anwendungsfelder**
Dr. Lars Rebenklau - Fraunhofer IKTS, Dresden
- 11:50 Uhr **Mittagspause**
- 13:00 Uhr **Dickschicht-Pastenentwicklung für die Sensorik, die Leistungselektronik und die Hochfrequenztechnik**
Dr. Stefan Körner - Fraunhofer IKTS, Dresden

- 13:20 Uhr **Additive Fertigungsverfahren für hybride keramische Elektronikkomponenten**
Dr. Steffen Ziesche - Fraunhofer IKTS, Dresden
- 13:40 Uhr **Digitales Heizen: Dickschichtheizelemente im Produktionsumfeld**
Ronald Claus von Nordheim, watttron GmbH, Freital
- 14:00 Uhr **Kaffeepause**
- 14:30 Uhr **Laborführungen**
- 16:00 Uhr **Abschlussdiskussion und Ende der Veranstaltung**

Wir bitten um Anmeldung per Email an martin.oppermann@tu-dresden.de bis **spätestens Montag, 20.03.2023 16:00 Uhr**. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, zählt die Reihenfolge der Anmeldungen.